

成都佳驰电子科技股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下。

为了满足公司经营发展的需要，提高资金使用效率，优化供应商结算方式，公司（含子公司）2026年度拟向银行申请不超过人民币2.5亿元（含本数）的综合授信额度。拟申请综合授信额度的银行为中国银行股份有限公司成都青羊支行、交通银行股份有限公司成都成华支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行，授信业务品种包括但不限于：银行承兑汇票、信用证、票据贴现等相关授信业务。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以授信额度内银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东会进行审议表决。以上综合授信无需公司缴纳保证金或提供担保，公司若在实际授信过程中缴纳保证金或提供相关担保将按照有关规定履行相应审议程序。

为提高工作效率，提请股东会授权经营管理层在上述授信额度范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况办理授信额度项下的授信业务等具体事宜。

本次综合授信额度事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。在有效期限内，授信额度可循

环使用。公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日